

平成23年6月10日

会員各位

関西大学科学技術振興会
会長 紀和 隆
関西大学先端科学技術推進機構
機構長 石川 正司

平成23年度 第2回研究会の開催について（ご案内）

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、本会の運営、事業の遂行に際しまして、ご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

今年度の研究会は、会員相互の交流をさらに深めるため、会員企業のPRの機会を新たに設けることになりました。

つきましては、平成23年度 第2回研究会を下記のとおり開催したく、是非ご出席賜りますようご案内申し上げます。

ご登録の会員に限らず、ご興味のある社員の方々のご参加もお待ちしております。

敬具

記

○ 日 時 平成23年7月23日（土）14：00～18：00<交流会を含む>

○ 場 所 関西大学 校友・父母会館 2階会議室<裏面地図参照>
阪急千里線「関大前」駅南口下車徒歩約5分

○ 研究会プログラム

1. 学の実化賞受賞記念講演

「DLC膜を滑り面に使用する工作機械用ハイブリッドガイド」<14:00～15:00>
関西大学システム理工学部 教授 北嶋 弘一 氏

2. 「切削工具開発の最新動向」<15:10～16:10>

日立ツール株式会社 商品開発センター センター長 工学博士 赤松 猛史 氏

3. 会員企業のPR <16:20～16:50>

聖和精密工機株式会社 / 日章アステック株式会社

4. 交流会 <17:00～18:00>

場 所 関西大学 100周年記念会館 レストラン紫紺
会 費 2,000円徴収いたします

以 上

(追伸)

1. 準備の都合上、ご出席の有無を同封の「FAX送付状」またはE-mail（アドレス：sentan@ml.kandai.jp）にて、7月11日（月）までにお知らせくださいますようお願いいたします。